

「ルミデコール SOLID(基材・ボンド)」成分表

●主たる構成材料（※印は有機物）

基材

構成材料名	配合率(重量%)
無機質骨材(珪砂)	60～70
無機質粉体(セメント 等)	30～40
無機質添加剤(増粘剤 等)	<1
※ 有機質添加剤	※ <3

※有機質分 3～4% 無機質分 96～97%

合成樹脂エマルション(ボンド)

構成材料名	配合率(重量%)
※ アクリル共重合体水性エマルション（固形分換算）	※ 25～30
水	65～70
※ 有機質添加剤	※ <5

※有機質分 30～35% 水分 65～70%

- 上記構成材料には、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤のいずれも使用していません。
- アスベスト(石綿)は一切使用していません。

以上